

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Struktur Jaringan Keras Gigi	6
2.1.1. Enamel	6
2.1.2. Dentin.....	7
2.1.3. Pulpa	7
2.1.4. Sementum	8
2.2. Sistem adesif.....	9
2.2.1. <i>Total Etch</i>	9
2.2.1.1. Komposisi dan Sifat Bahan.....	9
2.2.1.2. Mekanisme Ikatan.....	10
2.2.1.3. Kelebihan dan Kekurangan.....	11
2.2.2. <i>Self Etch</i>	12

2.2.2.1. Komposisi dan Sifat Bahan.....	12
2.2.2.2. Mekanisme Ikatan.....	13
2.2.2.3. Kelebihan dan Kekurangan.....	13
2.2.3. Bonding Agent.....	14
2.2.3.1. Jenis Bahan Bonding.....	14
2.3. Resin Komposit.....	17
2.3.1. Komponen.....	18
2.3.1.1. Matriks	19
2.3.1.2. Filler.....	19
2.3.1.3. Bahan Pengikat (<i>Coupling Agents</i>).....	20
2.3.2. Resin semen	20
2.3.2.1. Komposisi	21
2.3.2.2. Fungsi.....	21
2.3.2.3. Sifat.....	21
2.3.2.4. Kelebihan dan kekurangan.....	22
2.3.3. Fluoride	23
2.3.3.1. Peran Fluoride dalam Gigi	25
2.3.3.2. Jenis Sediaan Fluoride	26
2.3.4. Kekuatan Perlekatan	28
2.3.5. Adesi dan kohesiv	29
2.3.5.1. Faktor yang mempengaruhi adesi	30
2.3.6. <i>White spot Lesion</i>	32
2.3.6.1. Cara mencegah <i>White Spot Lesion</i>	33
2.3.6.2. <i>Treatment White Spot Lesion</i>	35
2.4. Kerangka teori.....	37
2.4.1. Keterangan Kerangka Teori.....	38
 BAB 3 KERANGKA KONSEP	41
3.1 Kerangka Konsep	41
3.2 Keterangan Kerangka Konsep.....	42
 BAB 4 METODE	44
 BAB 5 HASIL.....	45
 BAB 6 PEMBAHASAN	55

BAB 7 PENUTUP	64
7.1 Kesimpulan	64
7.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mikroposus pada enamel	7
Gambar 2.2 Bonding menggunakan teknik <i>total etch</i>	11
Gambar 2.3 Mekanisme ikatan teknik bonding <i>self-etch</i>	13
Gambar 2.4 Klasifikasi bahan bonding	17
Gambar 2.5 Perkembangan resin komposit.....	18
Gambar 2.6 Bentuk sediaan fluoride dan batasan penggunaannya	27
Gambar 2.7 Sudut kontak besar menunjukkan pembasahan yang kurang baik ..	31
Gambar 2.8 Sudut kecil menunjukkan pembasahan yang baik.....	32

DAFTAR SINGKATAN

1. WSL : *White Spot Lesion*
2. SDF : *Silver Diamine Fluoride*
3. CPP-ACP : *Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate*
4. SBS : *Shear bond strength*
5. μ SBS : *Microshear bond strength*
6. μ TBS : *Microtensile bond strength*